

# 壹、致股東報告書

於民國 113 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

三年前我卸下力成集團執行長一職，專注於集團各子公司資源的整合、加強團隊間的合作以建構一完整而具競爭力的半導體封測服務供應鏈。同時也啟動中高管理階層的培訓、接班，尤其在先進封測技術的研究、發展與製造，更是投入大量的人力與資源，將投資多年的團隊進行全方位的改造。

## 「前一年度營業結果」及「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」

集團在謝執行長帶領下，與力成呂總經理、超豐甯總經理、日本子公司 Tera Probe 橫山總經理、及晶兆成林總經理的配合努力下，我們順利挺過新冠疫情、美中科技貿易戰及地緣政治的影響，2021 年及 2022 年在營業額及獲利都創下歷史新高：

2021 年營業額達新台幣 837.94 億元，每股盈餘(EPS)為新台幣 11.54 元；

2022 年營業額達新台幣 839.27 億元，每股盈餘(EPS)為新台幣 11.60 元。

而 2023 年，全球經濟面臨嚴峻的挑戰，半導體產業經歷了 20 多年來最嚴重的衰退，力成集團也不可避免的營業額下跌了約 16%，2023 年營業額為新台幣 704.41 億元，每股盈餘(EPS)為新台幣 10.72 元。但我勉勵經營團隊：「在順境的環境下，業績及獲利的成長不是一流的管理，因為有很大的因素是屬於機會財；一流的經營團隊是在逆境的時候，能突破困境並創造未來業績及獲利成長的機會。」

## 「本年度營業計畫概要」

我們的經營團隊及全體員工在 2023 年做到了，雖然我們營業額衰退了，但在處分蘇州廠大部分的股權下，我們全年獲利 EPS 仍有超過一個股本的表現，更重要的是我們在先進封裝技術取得重大的進展，例如：

1. 大尺寸 FCBGA 順利取得大客戶的認證並開始量產；
2. TSV 為連結的 CIS CSP 取得客戶認證並開始量產，我們的良率及產品性能是業界最好的；
3. SIP/SIM，技術取得大客戶的認可及驗證並將進入量產；
4. FOPLP，過去高階產品客戶對大面板 FO 品質信心不足，但迫於多晶片 FO 整合在晶圓所能產出的量及高昂成本的困擾，尋求 FOPLP 為解決方案的客戶愈來愈多。

「未來公司發展策略」

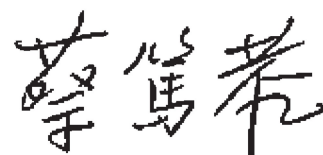
2024/2025 是力成迎來機會的關鍵年，我們要集中資源量產過去幾年來所開發的封測技術，尤其注重先進製程技術的開發及良率的穩定和提升，我們將：

1. TSV CIS CSP，運用技術拓展客戶；
2. HBM，在今年成為唯一能量產 Via Middle HBM 的 OSAT；
3. 挑戰 2.5D、3D 封測技術，為客戶提供另一具競爭力的『類 CoWoS』解決方案；
4. FOPLP，結合策略供應商開發更具彈性及競爭力的設備。

我們已經積極的重新啓動資本支出，以迎接 2025 與 2026 年機會的到來。

祝福大家有一繁榮的甲辰龍年！平安健康！

董事長：



蔡篤恭

# 力成科技股份有限公司

## 一一二年度營業報告書

### 一、112 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(IMF, International Monetary Fund) 113 年 1 月發布之「世界經濟形勢與展望」報告指出,112 年全球經濟成長率為 3.1%,113 年預計將維持在 3.1% 不變,114 年為 3.2%,113 年和 114 年的全球經濟成長率預計將低於 3.8% 的歷史平均水準(89-108 年)。112 年全球平均通膨率達 6.8%,IMF 預測 113 年將降到 5.8%,114 年為 4.4%,在供應鏈問題緩解及緊縮性貨幣政策的影響之下,多數地區的通膨下降速度比預期的快,全球面臨的通膨風險大致平衡。

受到全球地緣政治與科技競爭、戰事未歇壓力、重要國家進入大選年、全球供應鏈重組等多重不確定因素影響,全球經濟活動仍呈現連續性放緩。然而,在高速運算及生成式 AI 的帶動下,伺服器、車用及工業用等電子產品,將朝向更自動與更智慧化演進,為半導體產業帶來成長動能,低迷已久的半導體景氣有望在 113 年出現反彈。

根據資訊科技研究及顧問機構顧能(Gartner)報告預測,112 年全球半導體市場收入衰退近 11%,降至 5,330 億美元,鑒於 AI 專用晶片蓬勃發展,113 年全球收入有望大幅增長近 17%,達 6,240 億美元,整體的市場規模,甚至將超越 110 及 111 年。在臺灣半導體產業表現方面,工研院產科國際所於 113 年 2 月統計:112 年台灣 IC 產業產值達新台幣 43,428 億元,較 111 年衰退 10.2%,其中 IC 封裝業產值為新台幣 3,931 億元,較 111 年衰退 15.6%,IC 測試業產值為新台幣 1,906 億元,較 111 年衰退 12.8%。

面對 112 年全球經濟市場衰退,在車用電子、伺服器、高速運算及人工智慧(AI)等客戶端的需求持續成長之下,並受惠於客戶急單挹注,力成今年的表現優於原先預期。未來我們將持續深耕研發技術、提供優良品質與服務,並持續加大在 2.5D 及 3D 封裝布局,以滿足客戶及市場需求。

茲將本公司 112 年度的營運成果報告如下:

#### (一)112 年度營業實施情形

本公司 112 年度合併營收為新台幣 704 億 4 仟 1 佰萬元,較 111 年度的新台幣 839 億 2 仟 7 佰萬元減少約 16%;在盈餘方面,112 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 80 億零 9 佰萬元,較 111 年度之淨利新台幣 86 億 8 仟 7 佰萬元減少約 7.8%。

(二)預算執行情形:本公司 112 年度並未公開財務預測。

#### (三)財務收支情形

112 年度合併現金流量狀況:(單位:新台幣)

a.營業活動之現金淨流入	19,681,581 仟元
b.投資活動之現金淨流出	5,302,594 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	13,529,971 仟元
主要係償還銀行借款	

### (三)獲利能力分析

分析項目		年度	112 年度	111 年度
獲 利 能 力	營業利益 / 實收資本比率		107.40%	163.97%
	稅前純益 / 實收資本比率		158.64%	179.67%
	資 產 報 酬 率		8.49%	9.22%
	股 東 權 益 報 酬 率		14.04%	16.59%
	純 益 率		11.37%	10.35%
	每 股 純 益		10.72 元	11.60 元

### (四)研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，112 年度研究及發展費用約為新台幣 24.58 億元，約占全年合併營收的 3.49%。在現有的記憶體及邏輯產品封測技術的基礎下，積極開發先進封測及異質產品整合技術，包含銅柱凸塊(CPB, Copper Pillar Bump)、晶片級覆晶封裝(FCCSP, Flip Chip CSP)、大尺寸多晶片覆晶封裝(Large MCM FCBGA)、小晶片覆晶封裝(Chiplet FCBGA)、系統/模組級封裝(SiP/SiM)、內嵌天線封裝/天線模組(Antenna in Package / Antenna in Module, AiP/AiM)、高頻寬封裝堆疊(HBPOp, High Band Package on Package)、內嵌散熱片晶片級覆晶封裝(Embedded Heat Sink FCCSP)、晶圓級封裝(WLP, Wafer Level Package)、CMOS 影像感測器(CIS CSP, CMOS Image Sensor Chip Scale Package)、2.5D/3D TSV 及扇外型晶圓級/面板級封裝(FOPLP, Fan-Out Wafer/Panel Level Package)等封裝技術，為客戶提供全方位的解決方案。藉由 5G 天線封裝(AiP, 5G Antenna in Package)技術及 5G 射頻(5G RF)實驗室，能提供客戶 5G 天線封裝產品之效能驗證；在 CMOS 影像感測器(CIS)方面，則運用矽穿孔(TSV)連接技術，提升影像顯示之讀取速度，積極發展其應用於醫療、監控及車用的晶圓級晶片尺寸封裝；在高頻寬記憶體(HBM, High Bandwidth Memory)產品方面，也運用矽穿孔(TSV)之連接技術，提升記憶體產品之頻寬與速度，應用於高效能運算(HPC, High Performance Computing)產品與雲端伺服器；扇外型晶圓級/面板級封裝(FOWLP/FOPLP)方面，更因應後摩爾定律時代在晶片微縮化(Chip Scaling)製程上所面臨的困難，積極密切的與客戶進行相關產品的開發及驗證。

## 二、113 年度營業計劃概要

### (一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)及提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
- 4.以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

### (二)預期銷售數量

依據世界半導體貿易統計(The World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)於 112 年 11 月發布的 113 年半導體銷售預測，113 年全球半導體市場將年成長 13.1%，銷售額達 5,883 億美元，其中記憶體將是成長最主要的部分，年增 44.8%。WSTS 預期，所有市場都可望成長，歐洲及日本市場將分別成長 4.3%及 4.4%，美洲市場將成長 22.3%，亞太地區成長 12%。

針對台灣地區的半導體產業發展，工研院產科國際所預期，隨著庫存調整進入尾聲、終端消費市場需求回溫，加上 AI 及高效能運算等應用需求持續推升之下，IC 設計、製造與封測產業都有望擺脫市況不佳的情勢，逐步恢復正成長態勢，預估 IC 產業產值將達新台幣 4.9 兆元，較 112 年成長 14.1%。顯示台灣半導體產業強韌的全球競爭性。

展望 113 年，隨著各類型新興應用興起，包含人工智慧(AI)、電動車、自駕車、資料中心、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品，及各式行動裝置的創新功能推陳出新，半導體將依然是 ICT 產業的領頭羊，成長性依然可期。

值得注意的是，全球供應鏈重組趨勢，朝向區域化，短鏈化發展，全球貿易前景不確定性升高。此外，地緣政治隱憂，區域戰爭短期間內不易解決，衝擊能源供應，影響產業民生。儘管主要歐美國家通膨壓力略有降溫，惟仍偏高，牽動經濟與金融情勢。中國大陸，經濟持續停滯，通貨緊縮問題日益惡化，影響全球經濟復甦，同樣需要進一步密切觀察。

預估 113 年各式產品的生產量，邏輯晶片封測將持續大幅成長，記憶體晶片封測則穩健中見到回升的契機，113 年各類產品的預測生產數量如下表：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 120 億顆
測試	約 65 億顆
晶圓級封裝	約 80 萬片
晶圓測試	約 175 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SiP)	約 1.26 億顆

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短產品交期及降低運送成本。
- 2.維持記憶體產品封裝及測試服務的產業龍頭地位。
- 3.持續拓展邏輯產品(Logic)業務，並積極拓展覆晶封裝(FC, Flip Chip)、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝(WLP, Wafer Level Package)、晶圓級測試(CP, Chip Probing)、矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝(TSV CIS)、以矽穿孔為導通技術的多晶片記憶體堆疊(3D-IC memory stacking)、系統級封裝(SiP, System in Package)及扇外型封裝(Fan-Out Package)的業務成長。
- 4.進一步維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於產品的產品成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司整體的競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

